

新調査レポートのご案内

ICパッケージ基板レポート2019

- * 発刊日：2019年11月25日
- * 体裁：A4／211頁
- * 価格(税込)：297,000円(レポート本体＋CD)

※ご利用範囲は同一法人内に限定されます

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-12東日本橋榎町ビル8F-A

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

TEL: 03-5829-3891 FAX: 03-5829-3892

<http://www.jms21.co.jp/>

調査内容

第一章 総論

- ICパッケージ基板市場全体の推移・予測(2015-2028)
- フリップチップ基板市場全体の推移予測(2015-2028)
- ICパッケージ基板主要メーカー販売実績(2018)

第二章 FCBGA基板

- FCBGA基板市場規模－全体(2018)
- FCBGA基板応用分野別・層数別市場規模(2018)
 - FCBGA基板応用分野別市場規模(2018)
 - FCBGA基板層数別市場規模(2018)
 - FCBGA基板応用分野別のメーカー別・層数別市場規模(2018)
 - FCBGA基板主要メーカー応用分野別・層数別販売実績(2018)
- FCBGA基板の応用分野別市場規模推移予測(2015-2028)
- FCBGA基板の層数別市場規模推移予測(2015-2028)
- 応用分野別FCBGA基板の層数別市場規模推移予測(2015-2028)

第三章 FCCSP基板

- FCCSP基板の市場規模－全体(2018)
- FCCSP基板タイプ別メーカーシェア(2018)
- FCCSP基板主要メーカー販売実績(2018)
- FCCSP基板の市場規模推移予測(2015-2028)

調査内容

第四章 ICパッケージ基板メーカー事例研究

<日本メーカー>

1. イビデン株式会社
2. 新光電気工業株式会社
3. 京セラ株式会社
4. 凸版印刷株式会社

<韓国・台湾・その他メーカー>

1. Unimicron Technology Corporation
2. Nan Ya Printed Circuit Board Corporation
3. Kinsus Interconnect Technology Corporation
4. Samsung Electro-Mechanics Company Limited
5. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

<調査項目>

1. 会社概要
2. ICパッケージ基板事業
 - 2-1. 生産拠点
 - 2-2. 主要製品ラインナップ
 - 2-3. ICパッケージ基板の販売状況

レポートの概要及び申込み要項

< 発刊日・頁数・価格 >

- ◆ 発刊日: 2019年 11月25日
- ◆ 体裁: A4/211頁
- ◆ 価格(税込): 297,000円 (レポート本体+CD)

< 申込み要項 >

▼ 支払方法

レポート発刊後、請求書をレポートと同封でお送りいたします。お支払いは原則として、請求日の翌月末日までに銀行振り込みにてお願いいたします。

▼ 納品形態

- 製本レポート 1部
- CD(PDFファイル) 1枚

▼ 調査資料のお取り扱いについて

調査資料(レポート)のデータについては、ご契約頂いた同一法人内にその利用範囲を限定させていただきます。マルチライセンスをご希望の場合は、別途お問合せください。また、第三者への譲渡、複写を禁止いたします。

※ 外部向けプレゼンテーション資料として一部データのご使用については、この限りではございませんので、ご相談ください。

申込書

年 月 日

株式会社ジャパンマーケティングサーベイ 御中 (Fax:03-5829-3892)

調査レポート: ICパッケージ基板レポート2019

該当するお申し込み項目に☑をご記入下さい

- 前項の調査資料の取扱いについて同意の上、レポートの購入を申し込む
- レポート担当者からの概要紹介、内容確認の上、検討を希望する

申込企業名: _____.

申込責任者: _____ 同役職: _____.

連絡担当者: _____ 同所属: _____.

所在地: (〒 _____)

TEL: _____ Email: _____.

連絡事項等: